DIN 50003:2024-06 (D)

Klebungen in elektronischen Anwendungen - Bestimmung der Wärmeleitfähigkeit von Materialien zur Wärmeableitung

Inhalt

Seite

Vorwort ... 3

1 Anwendungsbereich ... 4

2 Normative Verweisungen ... 4

3 Begriffe ... 5

4 Auswahl eines geeigneten Verfahrens ... 5

5 Übersicht möglicher Verfahren zur Bestimmung der Wärmeleitfähigkeit ... 6
5.1 Übersicht ... 6
5.2 ISO 8301, *Wärmeschutz — Bestimmung des stationären Wärmedurchlasswiderstandes und verwandter Eigenschaften — Verfahren mit dem Wärmestrommessplatten-Gerät* ... 7
5.2.1 Kurzbeschreibung: ... 7
5.2.2 Vorteile der Methode ... 7
5.3 ISO 8302, *Wärmeschutz — Bestimmung des stationären Wärmedurchlasswiderstandes und verwandter Eigenschaften — Verfahren mit dem Plattengerät* ... 7
5.3.1 Kurzbeschreibung: ... 7
5.3.2 Vorteile der Methode ... 7
5.4 DIN EN ISO 22007-2, *Kunststoffe — Bestimmung der Wärmeleitfähigkeit und der Temperaturleitfähigkeit — Teil 2: Transientes ebenes Wärmequellenverfahren (Hot-Disk-Verfahren)* ... 7
5.4.1 Kurzbeschreibung: ... 7
5.4.2 Vorteile der Methode ... 8
5.5 DIN EN ISO 22007-4, *Kunststoffe — Bestimmung der Wärmeleitfähigkeit und der Temperaturleitfähigkeit — Teil 4: Laserblitzverfahren* ... 8
5.5.1 Kurzbeschreibung: ... 8
5.5.2 Vorteile der Methode ... 8
5.5.3 Weitere Hinweise: ... 8
5.6 ASTM D 5470-17, *Standard Test Method for Thermal Transmission Properties of Thermally Conductive Electrical Insulation Materials* ... 8
5.6.1 Kurzbeschreibung: ... 8
5.6.2 Vorteile der Methode ... 9
5.6.3 Weitere Hinweise: ... 9

6 Auswertung und Darstellung der Ergebnisse ... 9

7 Prüfbericht ... 9

Literaturhinweise ... 10

Tabellen

Tabelle 1 — Einordnung möglicher Verfahren zur Bestimmung der Wärmeleitfähigkeit ... 6